

裕太微电子股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 与填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十一次会议，于 2026 年 5 月 20 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。2026 年 7 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。2026 年 9 月 1 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等相关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者的利益，公司就 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设和前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方面未发生重大不利变化。

2、假设本次发行于 2026 年 9 月底实施完成，该完成时间仅为公司用于本测算的估计，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终以本次发行获得上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准。

3、假设本次发行股票数量为 16,000,000.00 股（以预案出具日公司总股本 80,000,000.00 股的 20%测算），该发行股票数量仅为公司用于本测算的估计，不代表公司对本次发行实际发行股票数量的判断，最终以本次发行获得上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册并实际发行股份数量为准。

4、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响。

5、不考虑发行费用，假设本次向特定对象发行 A 股募集资金总额为人民币 68,895.28 万元。

6、假设公司 2026 年中期不进行利润分配，且无其他可能产生的股权变动事宜。

7、假设公司 2026 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净亏损分别在上年同期的基础上按照持平、减少 10%和增加 10%的业绩变动幅度测算。

8、在预测公司总股本时，以截至本预案出具日公司总股本 8,000.00 万股为基础，同时仅考虑本次向特定对象发行股票对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜（如资本公积转增股本、股票股利分配、限制性股票回购）。

9、上述假设仅为测试本次向特定对象发行 A 股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。

（二）对公司即期回报的摊薄影响

基于上述假设，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标

的影响如下：

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日	2026 年度/2026 年 12 月 31 日	
		发行前	发行后
总股本（万股）	8,000.00	8,000.00	9,600.00
假设 1：2026 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净亏损较 2025 年持平			
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	-15,768.36	-15,768.36	-15,768.36
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	-1.99	-1.98	-1.65
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	-1.99	-1.98	-1.65
假设 2：2026 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净亏损较 2025 年减少 10%			
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	-15,768.36	-14,191.53	-14,191.53
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	-1.99	-1.78	-1.49
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	-1.99	-1.78	-1.49
假设 3：2026 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净亏损较 2025 年增加 10%			
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	-15,768.36	-17,345.20	-17,345.20
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	-1.99	-2.18	-1.82
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	-1.99	-2.18	-1.82

二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后，公司总股本和净资产将有所增加，而募集资金的使用和实施需要一定的时间。根据上表假设基础进行测算，本次发行可能不会导致公司每股收益被摊薄。但是一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况的可能性，公司依然存在即期回报因本次发行而有所摊薄的风险。

公司对 2026 年度相关财务数据的假设仅用于计算相关财务指标，不代表公司对 2026 年度经营情况及趋势的判断，也不构成对公司的盈利预测或盈利承诺。

投资者不应根据上述假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的公司不承担赔偿责任。

三、本次发行的必要性和合理性

本次募集资金投资项目经过公司董事会谨慎论证，围绕公司主营业务及未来布局开展，符合国家政策支持及公司未来整体战略方向，有利于进一步提高公司核心竞争力，推动公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。关于本次发行的必要性和合理性详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”的相关内容。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后，拟用于面向数据中心场景的新一代高速互联网络通信方案研发项目、面向汽车场景的新一代高速通信芯片研发及产业化项目，拟投资项目与公司当前主营业务方向相符合，有利于公司巩固行业地位，进一步提升公司的技术水平和运营服务能力，从而进一步增强公司的盈利能力和核心竞争力。

（一）人员储备

集成电路设计属于人才密集型行业，优秀人才是公司持续创新和发展的核心驱动力。公司自成立以来始终注重研发团队建设，持续引进和培养高水平技术人才，目前已形成一支结构合理、经验丰富的研发队伍。截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员共计 272 人，占公司总人数的 68.17%，其中硕士及以上学历占比超过 64.34%。

公司核心研发团队背景雄厚，多位核心成员来自高通、美满电子、海思、紫光展锐等国际知名芯片企业，且具备丰富的集成电路设计经验。公司董事长兼总经理史清博士，毕业于中科院上海微系统与信息技术研究所微电子学与固体电子学专业，长期深耕高速有线通信、无线通信及卫星导航等领域的芯片研发与产业化，曾主持或参与开发过多款量产芯片产品，覆盖以太网、WiFi、无线通信等方

向。史清博士曾牵头承担工信部等国家级重点项目，在高速互联芯片架构设计、先进工艺集成及产品工程落地方面积累了深厚的技术领导力与系统工程经验。公司雄厚的人才储备保障了公司的持续创新能力，能够助力公司高效完成新技术研发与产业化，为本次募投项目的实施提供坚实的人才保障。

本次募集资金投资项目所需新增的人员将根据岗位性质和公司的整体人力资源战略规划，通过外部招聘、内部培养等多种方式进行补充。公司各部门将按照本次募集资金投资项目的实施计划，对所需各岗位、各工种的人员进行提前规划，使得募集资金投资项目拥有充足的人力储备。

（二）技术储备

公司长期专注于高速通信领域的物理层技术创新，已构建起涵盖复杂信号链调理、高速率通信协议逻辑及超大规模系统验证的综合研发平台。这种深厚的底层设计经验与工程化能力，支撑了公司在既有细分市场的领先地位，并为业务向更宽带宽、更高集成度应用场景的演进提供了关键的技术资源支撑。同时，公司深耕高速有线通信芯片领域多年，围绕高速有线通信构建了完整的技术体系。在核心技术层面，公司自主研发的高性能 SerDes 设计技术、高性能 ADC 设计技术、低抖动锁相环设计技术等底层技术，构成了公司的核心竞争壁垒。上述技术经过多代产品迭代验证，已广泛应用于不同速率等级的产品中，具备高度的成熟度和可复用性。

同时，面向数据中心场景的新一代高速互联网络通信方案研发项目在底层通信架构与信号处理逻辑等维度可有效复用公司现有技术资产。公司已在不同速率等级和不同应用场景的产品研发中积累了丰富的技术经验，形成了完整的技术迭代方法论。通过将长期沉淀的工程经验与本项目需求相结合，公司能够有效降低研发过程中的技术风险，缩短产品验证周期，为项目的顺利推进提供保障。面向汽车场景的新一代高速通信芯片研发及产业化项目研发的更高速率、更高性能的产品，均是在公司现有核心技术体系基础上的延伸和升级，公司深厚的技术积累为该项目研发目标的顺利实现提供了坚实的技术基础。

（三）客户储备

公司产品覆盖数通、车载、消费、工业、电信、安防、等多个领域，产品分为车规级、工规级、商规级等不同性能等级，以及百兆、千兆、2.5G 等不同传输速率和不同端口数量的产品组合，广泛应用于各类以太网设备接入设备以及各类车载和工业的特种数据传输场景的应用需求。

公司产品目前已应用到上千家不同领域的客户或终端客户中，并已进入更多客户的供应商序列等待产品测试通过和出货。未来，公司将继续保证产品质量，持续为老客户提供优质服务，不断拓展新客户资源，以求获取更多的市场份额。

综上，公司在人员、技术和客户等方面具有丰富的储备，能够为本次发行募集资金投资项目的实施提供有力保障。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险。公司填补即期回报的具体措施如下：

（一）加快募集资金投资项目建设以实现预期效益

公司本次发行募集资金主要用于面向数据中心场景的新一代高速互联网络通信方案研发项目、面向汽车场景的新一代高速通信芯片研发及产业化项目研发，符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。随着项目逐步实施将对公司经营业绩带来显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。为此，公司将积极调配各方面资源，做好募投项目实施前的准备工作，加快推进项目实施并争取早日实现预期收益。本次发行募集资金到位后，公司将尽可能提高募集资金利用效率，增加以后年度的股东回报。

（二）加强募集资金及募投项目的管理，保证募集资金使用合规高效

本次发行的募集资金到位后，公司将严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司章程》《裕太微电子股份有限公司募集资金管理办法》的规定，开设专户存储，严格管理募集资金使用，确保募集资金按照既定用途得到充分有效利用。公司、保荐机构、

存管银行将持续对公司募集资金使用进行检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

（三）提升营运效率，加强经营管理和成本控制

公司将进一步优化业务流程和完善内部控制制度，提高公司日常运营效率，努力实现收入水平和盈利能力的双重提升。公司将加强对研发、采购、销售等各个环节流程中的各项经营、管理、财务费用的事前、事中、事后管控，有效防范和管控公司的经营风险。通过以上措施，公司将全面提升运营效率，降低费用成本，提升经营业绩。

（四）严格执行利润分配政策，保障投资者利益

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的利润分配政策和内部监督机制，公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求以及《上市公司章程指引》的精神，建立健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将根据经营情况与发展规划，严格执行分红政策，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，强化对投资者的回报机制。

（五）健全员工激励机制，加强人才储备

公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，持续推动人才发展体系建设，建立与公司发展相匹配的人才结构，最大限度地激发和调动员工积极性，挖掘员工的创造力和潜在动力，为公司的可持续发展提供可靠的人才保障。

（六）持续提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保公司各组织机构设置合理、运行有效，确保股东会、董事会和管理层之间权责分明、相互制衡，从而构建起一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司

发展提供制度保障。

公司提示投资者，上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。

六、相关主体对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施出具的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：

“（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）本人承诺约束并控制本人的职务消费行为；

（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（4）本人同意，由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）本人同意，如公司未来拟对本人实施股权激励，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；

（7）若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日